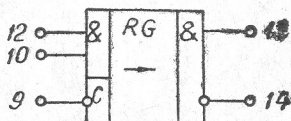


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



1—3 — свободные	10 — вход <i>B</i>
4 — +5 В	11 — общий
5—8 — свободные	12 — вход <i>A</i>
9 — вход <i>Cp</i>	13, 14 — выходы

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$)

Напряжение источника питания	+5 В $\pm 10\%$
Выходное напряжение логического «0» Δ при максимальном числе нагрузок для микросхем:	
1ИР061А, К1ИР061А	не более 0,28 В
К1ИР061Б	не более 0,50 В
Выходное напряжение логической «1» Δ при максимальном числе нагрузок для микросхем:	
1ИР061А, К1ИР061А	не менее 2,7 В
К1ИР061Б	не менее 2,2 В
Входной ток логического «0» для микросхем:	
1ИР061А, К1ИР061А	не более 1,5 В
К1ИР061Б	не более 1,7 В
Входной ток логической «1» для микросхем:	
1ИР061А, К1ИР061А	не более 60 мкА
К1ИР061Б	не более 80 мкА
Время задержки распространения логического уровня для микросхем:	
1ИР061А, К1ИР061А	не более 60 нс
К1ИР061Б	не более 100 нс
Частота переключения	не более 5 МГц
Нагрузочная способность	10
Помехоустойчивость при максимальном числе нагрузок для микросхемы 1ИР061А	не менее 0,7 В

Δ Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

**ВОСЬМИРАЗЯДНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕГИСТР**

**1ИР061А
К1ИР061А
К1ИР061Б**

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

выходное напряжение логического «0» для микросхем	
1ИР061А, К1ИР061А	не более 0,40 В
К1ИР061Б	не более 0,65 В
выходное напряжение логической «1» для микросхем	
1ИР061А, К1ИР061А	не менее 2,4 В
К1ИР061Б	не менее 2,0 В

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное выходное напряжение логического «0» для микросхем:	
1ИР061А, К1ИР061А	0,40 В
К1ИР061Б	0,65 В
Минимальное выходное напряжение логической «1» для микросхем:	
1ИР061А, К1ИР061А	2,4 В
К1ИР061Б	2,0 В
Выходной ток при напряжении логического «0»	15 мА
Выходной ток при напряжении логической «1»	0,8 мА
Максимальное напряжение, которое может подаваться на входы	5,5 В
Максимальная статическая мощность потребления при $U_{вх} = 5,5$ В	180 мВт
Напряжение статической помехи для микросхемы 1ИР061А	0,4 В
Предельная температура кристалла для микросхемы 1ИР061А	+150° С
Тепловое сопротивление кристалл — среда для микросхемы 1ИР061А	0,25°С/мВт

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Напряжение источника питания +6 В

○ При температуре окружающей среды, допускаемой условиями эксплуатации.

**1ИР061А
К1ИР061А
К1ИР061Б**

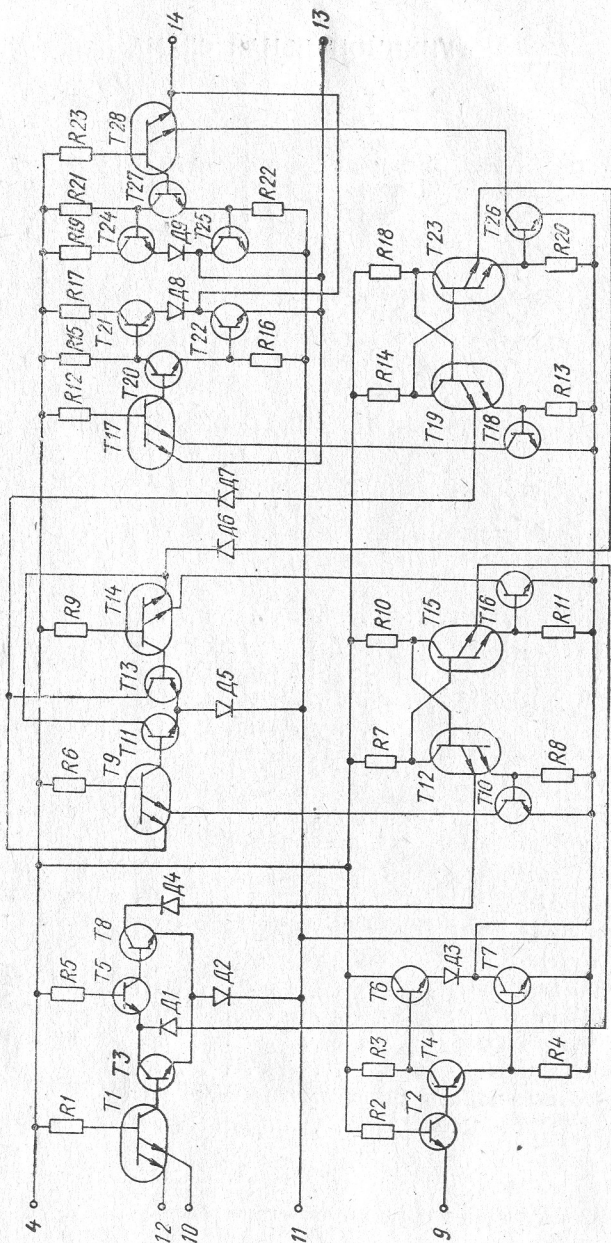
**ВОСЬМИРАЗРЯДНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕГИСТР**

Напряжение источника питания в течение 5 мс для микросхемы 1ИР061А	+7 В
Постоянное напряжение на функциональных входах	+5,5 В
Отрицательное напряжение на входах	минус 0,3 В
Гок нагрузки при логическом «0» на выходах . . .	18 мА
Максимальная емкость нагрузки	200 пФ

ВОСЬМИРАЗРЯДНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕГИСТР

1ИР061А
К1ИР061А
К1ИР061Б

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА

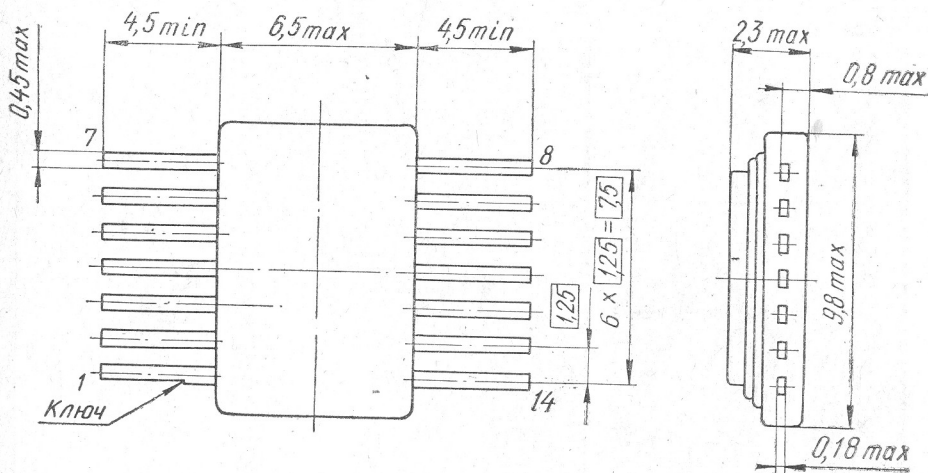


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

Микросхемы серии 106 (К106) выполнены в прямоугольном металлокерамическом корпусе.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
микросхем серии 106 (К106)



Масса микросхем серии:
106 — не более 0,35 г,
К106 — не более 0,5 г

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

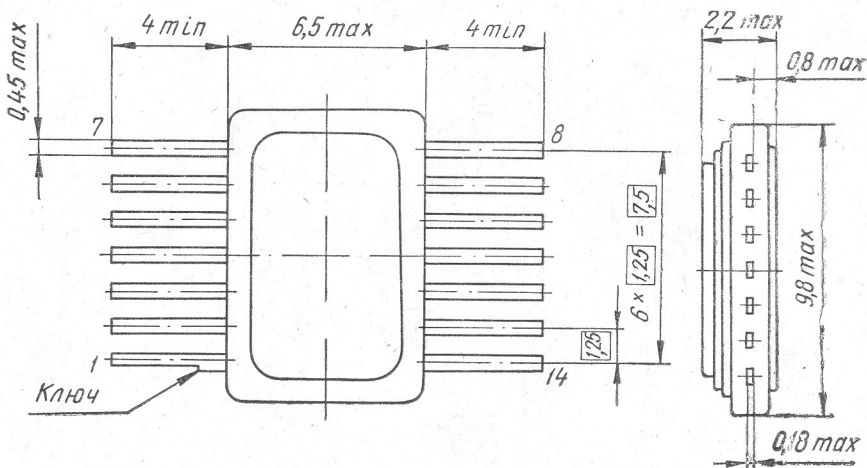
Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов показана условно.

Микросхемы серии 106-1 (К106-1), 106-2 (К106-2) выполнены в прямоугольном металлостеклянном корпусе с металлическим дном.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

микросхем серии 106-1 (К106-1), 106-2 (К106-2)



Масса микросхем серии:

106-1, 106-2 — не более 0,35 г,

К106-1, К106-2 — не более 0,6 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов показана условно.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация для микросхем серии:

106

диапазон частот от 5 до 5000 Гц
ускорение до 40 g

К106

диапазон частот от 5 до 5000 Гц
ускорение до 40 g

Одиночные удары для микросхем серии 106:

ускорение до 1000 g
длительность удара от 0,2 до 1,0 мс

Линейные нагрузки для микросхем серии:

106

ускорение до 150 g

К106

ускорение до 25 g

Температура окружающей среды для микросхем серии:

106 от минус 60 до +125° С

К106 от минус 45 до +85° С

Многократные циклические изменения температуры

для микросхем серии:

106 от минус 60 до +125° С

К106 от минус 45 до +85° С

Относительная влажность воздуха для микросхем серии 106 при температуре +40° С и серии К106 при

температуре +25° С до 98%

Для микросхем серии 106:

Атмосферное давление от 5 мм рт. ст. до 3 атм

Иней, роса.

Соляной туман.

Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка \circ 10 000 ч

Срок сохраняемости \circ для микросхем серии:

106 12 лет

К106 6 лет

\circ В условиях и режимах, допускаемых ОТУ, ЧТУ или ТУ.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ 11 6К0.340.010—74 и требованиями, изложенными ниже.

Перед началом монтажных и сборочных работ с микросхемами следует принять меры, исключающие появление на выводах микросхемы электростатических зарядов с величиной потенциала более 50 В, для чего тщательно заземлить на рабочем месте жало паяльника, пинцеты, металлические части стульев через сопротивление 1 МОм. Монтаж микросхем следует производить только в обесточенном состоянии.

Запрещается кручение выводов микросхем вокруг оси и изгиб в плоскости корпуса микросхемы. Изгиб выводов следует производить на расстоянии не менее 1 мм. Радиус изгиба — не менее 0,36 мм.

Микросхемы следует устанавливать на печатную плату вплотную или с зазором до 0,7 мм с последующей прилакировкой и приклейкой.

Лужение выводов следует производить двукратным погружением в расплавленный припой при температуре 250°С в течение не более 2 с, интервал между двумя погружениями — не менее 5 мин.

Пайку выводов допускается производить одножальным заземленным паяльником при температуре 265°С в течение 3 с, интервал между пайками двух соседних выводов — не менее 3 с, или групповым паяльником с температурой 265°С в течение 2 с, интервал между двумя повторными пайками — не менее 5 мин. Расстояние от корпуса до места лужения или пайки — не менее 1 мм.

После монтажа микросхемы должны быть защищены лакокрасочным покрытием, устойчивым к воздействию условий эксплуатации.

Рекомендуемое покрытие — лаки УР-231 по МРТУ 6-10-863—69 и Э-4100 по МРТУ 6-10-857—69.

Приклейку микросхем следует производить клеем АК-20 по ТУ 6-10-1293—72.